

参加者の皆様へ

■ 開催概要

会 期：2026年6月20日(土)
会 場：京都大学 芝蘭会館
開催方法：会場開催(オンサイト)のみ

■ 参加登録・参加費

参加区分	早期登録	通常登録
	2026年5月19日(火)まで	2026年5月20日(水)～6月20日(土)
会 員	5,000円	6,000円
非会員	10,000円	11,000円
大学院生 (社会人院生除く)	3,000円	
高校生・大学生・ 専門学校生	無料	

※学生の方は、参加登録時に学生証の画像を添付してください。

■ 参加費の税区分

会 員：不課税
非会員：課税

■ 会場での当日参加登録について

【場 所】京都大学 芝蘭会館 1階

【受付時間】2026年6月20日(土) 8:30～16:00

当日参加登録される方は、早期・通常登録と同じようにオンラインでのご登録・クレジット決済となります。現地(会場)の総合受付での参加費支払い(現金およびクレジット決済)受付は行いませんのでご了承ください。

■ 懇親会について

【日 時】2026年6月20日(土) 17:30～18:55(ポスターセッションと同時開催)

【会 場】京都大学 芝蘭会館 2階 山内ホール・ホワイエ

【参加費】無料

【申 込】事前申込制・参加登録時にお申し込みください。

■ 参加証・領収書

早期登録・通常登録の方

- 参加証・領収書は、オンラインページのマイページからダウンロード、印刷ができます。
- 参加証は各自で印刷をして、当日忘れずにご持参ください。
総合受付で再発行はいたしませんので、ご注意ください。

会場で当日参加登録される方

オンラインで参加登録・参加費のお支払いを完了後、総合受付にて名札をお受け取りください。受け取り時は「入金完了とログイン方法のお知らせ」のメール画面をご提示ください。参加証・領収書はオンラインのマイページからダウンロード、印刷ができます。

※ネームホルダーを各自でお取りいただき、会場内では必ずご着用ください。

■ クロークについて

【場 所】京都大学芝蘭会館 1階

【受付時間】2026年6月20日(土)8:30~19:00

※貴重品、割れ物、傘、生ものはお預かりできませんのでご了承ください。

■ ランチョンセミナーについて

第2会場(山内ホール)にて行います。

ランチョンセミナーにて、昼食をご用意しております。

ランチョンセミナーにご参加の方は入り口にてお弁当をお受け取りの上、会場にお入りください。数に限りがございますことをご了承ください。

尚、事前の整理券配布はございません。

■ 企業展示

学術集会開催中、2階 ホワイエにて企業展示を行います。

■ プログラム・抄録集

- 日本免疫治療学会会員の方および5月31日(日)までに参加登録および参加費のお支払いを完了された非会員・大学院生の方へは、事前に送付しておりますのでご持参ください。
- 6月1日(月)以降に参加登録をされた非会員の方へは、総合受付でお渡しします。高校生・大学生・専門学校生の方は冊子の配布はありませんが、別途ご案内するPDF版をご覧ください。
- 当日に購入を希望される方には、1部1,000円(税込)で販売いたします。

■ 参加証・領収書のダウンロード・印刷方法

【ログインページURL】 <https://online-conference.jp/jrai23/login>

【ログインID】 参加登録時のメールアドレス

【パスワード】 参加登録時にご自身で設定した文字列

上記にてログイン後、画面右上の『マイページ』をクリックし、「参加証兼領収書のダウンロード・印刷はこちら」をクリックしてください。

■ ご参加の皆様への注意事項

- 会場内の写真・ビデオ撮影、録音、許可のない講演内容の引用等は一切禁止します。著作者に許可のない録音・録画・写真撮影は著作権法違反となります。このような行為を場内で見かけた際は、スタッフがお声掛けさせていただきます。なお、記録として運営事務局で撮影・録音をさせていただく場合がございます。
- 講演会場内での携帯電話の使用は進行の妨げとなりますので、電源をお切りいただくか、マナーモードの設定をお願いします。

■ 学会の新規入会・年会費

学術集会当日も新規入会および年会費のお支払いを受け付けております(年会費：5,000円)。

<入会手続きに関するお問い合わせ先>

一般社団法人 日本免疫治療学会 事務局 E-mail : jrai@soubun.org

■ お問い合わせ先

<第23回日本免疫治療学会学術集会 運営担当>

株式会社プロコムインターナショナル

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目6番地11 TFTビル東館9階

TEL : 03-5520-8822 E-mail : jrai23@procom-i.jp